

先进封装散热革新，利基 DRAM格局重塑

半导体行业周报

投资评级：推荐（维持）

报告日期：2026年04月20日

- 分析师：庄宇
- SAC编号：S1050525120003
- 分析师：何鹏程
- SAC编号：S1050525070002

- 分析师：张璐
- SAC编号：S1050526010002
- 联系人：石俊烨
- SAC编号：S1050125060011

研究创造价值

台积电导入SiC中介层，先进封装散热升级打开增量空间

台积电已启动12英寸SiC衬底交付，明年需求预期翻倍。随着英伟达GPU功率从H100的700W跃升至Feynman架构的4400W，传统硅中介层散热瓶颈凸显，SiC凭借3倍于硅的热导率（~490 W/m·K）成为关键升级方向。SiC中介层在CoWoS-S/L中的渗透，将为衬底厂商打开先进封装第二增长曲线，建议关注技术领先的SiC衬底企业。

存储大厂加速产能转移，利基型DRAM迎结构性机会

三星电子已正式停止接收LPDDR4/LPDDR4X新增订单，预计2026年底彻底停产，产线将于2027年Q1全部转向LPDDR5/LPDDR5X及HBM。三星此次计划停产LPDDR4系列，最核心的原因在于HBM和先进DDR5产品的利润率更高。叠加 AI 浪潮下先进内存供不应求，三星希望将有限晶圆、产能资源全部倾斜到利润率更高的产品线上，不再维持低利润旧代产品产能。三星停产 LPDDR4/4X 后，原有需求必须寻找替代来源。利基型DRAM市场有望出现市场空隙，中国大陆利基型存储厂有切入机会。

建议关注：天岳先进、兆易创新、北京君正。

中美“关税战”加剧风险

中美科技竞争加剧风险

产先进制程进度不及预期风险

AI模型大厂资本开支不及预期风险

重点关注公司及盈利预测

公司代码	名称	2026-04-17 股价	EPS			PE			投资评级
			2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	
300223.SZ	北京君正	116.79	2.48	4.35	5.4	47.09	26.84	21.62	未评级
603986.SH	兆易创新	288.96	0.78	1.38	1.8	370.32	209.13	160.62	未评级
688234.SH	天岳先进	95.2	-0.43	0.7	0.87	-221.40	136.00	109.43	买入

资料来源：Wind，华鑫证券研究（注：“未评级”盈利预测取自万得一致预期）

目录

CONTENTS

1. 半导体板块周度行情分析
2. 行业高频数据
3. 行业动态
4. 公司公告

01 半导体板块周度行情分析

研究创造价值

1.1、周涨幅排行

4月13日-4月17日当周，海外龙头总体呈上涨态势。其中，安森美半导体领涨，涨幅为20.92%，阿斯麦跌幅为-1.25%。

图表2：海外半导体龙头估值水平及周涨幅（%）

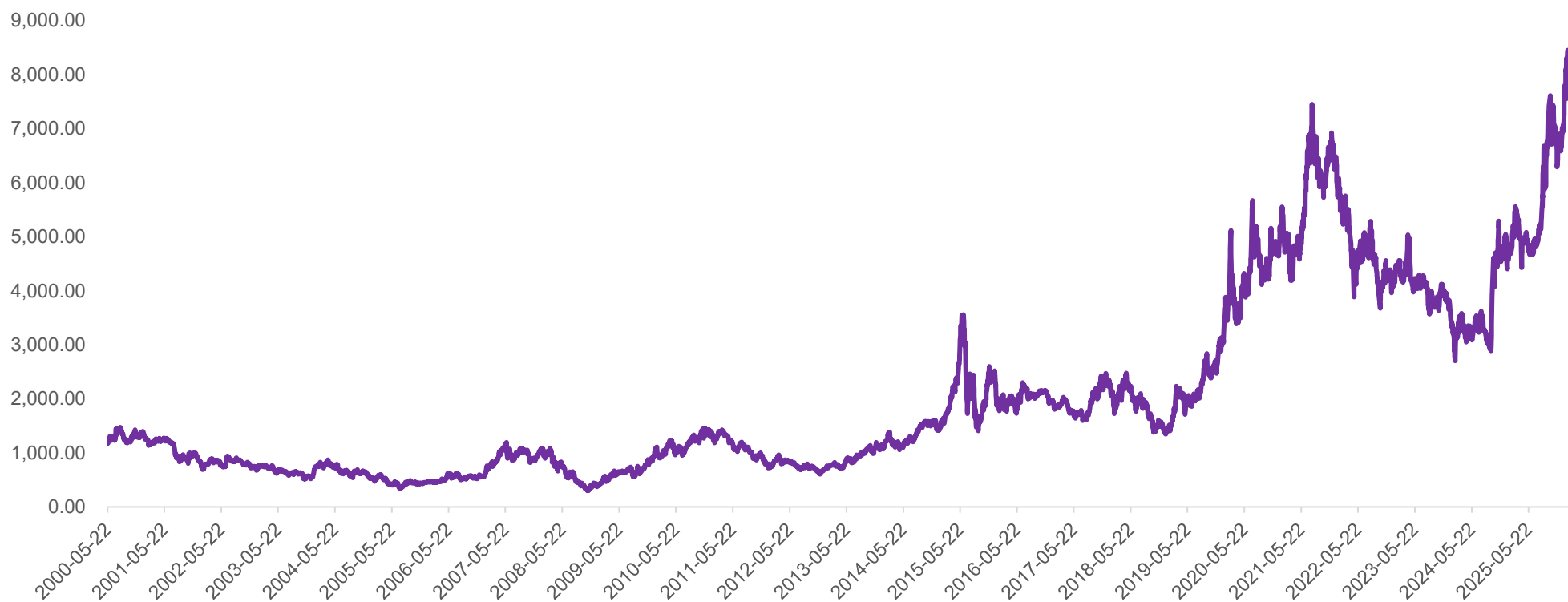
证券代码	证券简称	国家/地区	市值（亿元）	PE (LYR)	PB (MRQ)	周涨跌幅（%）		
处理器	INTC.O	英特尔 (INTEL)	美国	3439.39	-1288.16	3.01	9.81	
	QCOM.O	高通 (QUALCOMM)	美国	1453.25	26.23	6.30	6.36	
	AMD.O	超威半导体 (AMD)	美国	4538.70	104.70	7.20	13.61	
	NVDA.O	英伟达 (NVIDIA)	美国	49008.24	40.82	31.16	6.92	
存储	MU.O	美光科技 (MICRON TECHNOLOGY)	美国	5131.98	60.10	7.08	8.20	
模拟	TXN.O	德州仪器 (TEXAS INSTRUMENTS)	美国	2092.43	42.08	12.86	7.03	
	ADI.O	亚德诺 (ANALOG)	美国	1813.43	79.98	5.37	6.09	
	AVGO.O	博通 (BROADCOM)	美国	19248.32	83.23	24.10	9.42	
	NXP1.O	恩智浦半导体 (NXP SEMICONDUCTORS)	荷兰	545.89	27.01	5.43	5.71	
射频	SWKS.O	思佳讯 (SKYWORKS)	美国	88.72	18.60	1.54	4.67	
	QRVO.O	QORVO	美国	75.88	136.44	2.05	2.62	
功率半导体	STM.N	意法半导体	荷兰	393.01	236.75	2.20	12.01	
	ON.O	安森美半导体 (ON SEMICONDUCTOR)	美国	326.50	269.84	4.26	20.92	
	IFX.DF	英飞凌科技	德国	635.29	62.59	3.64	14.19	
光学	3008.TW	大立光	中国台湾	3476.85	16.34	1.84	12.77	
半导体设备	AMAT.O	应用材料 (APPLIED MATERIAL)	美国	3150.16	45.02	14.51	-0.64	
	LRCX.O	拉姆研究 (LAM RESEARCH)	美国	3341.71	62.37	32.94	1.49	
	KLAC.O	科天半导体 (KLA)	美国	2348.16	57.81	42.96	3.12	
	ASML.O	阿斯麦	荷兰	5749.14	51.06	23.95	-1.25	
硅片	6488.TWO	环球晶圆	中国台湾	2414.47	33.02	2.59	2.96	
	晶圆代工	2330.TW	台积电	中国台湾	610199.17	31.01	8.94	1.50
	GFS.O	格芯 (GLOBALFOUNDRIES)	开曼群岛	300.62	33.97	2.52	11.89	
化合物半导体	3105.TWO	稳懋	中国台湾	2285.04	134.91	5.50	16.16	
封装	ASX.N	日月光投资	中国台湾	636.67	49.33	5.78	15.10	
分销	ARW.N	艾睿电子 (ARROW ELECTRONICS)	美国	89.39	15.65	1.36	10.61	
	AVT.O	安富利 (AVNET)	美国	60.46	25.17	1.22	10.17	

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.2、申万一级行业估值水平

4月13日-4月17日当周，申万半导体指数整体呈现上升的态势。4月17日，申万半导体指数为8,012.48，周涨幅为5.23%。

图表3：近5年申万半导体指数

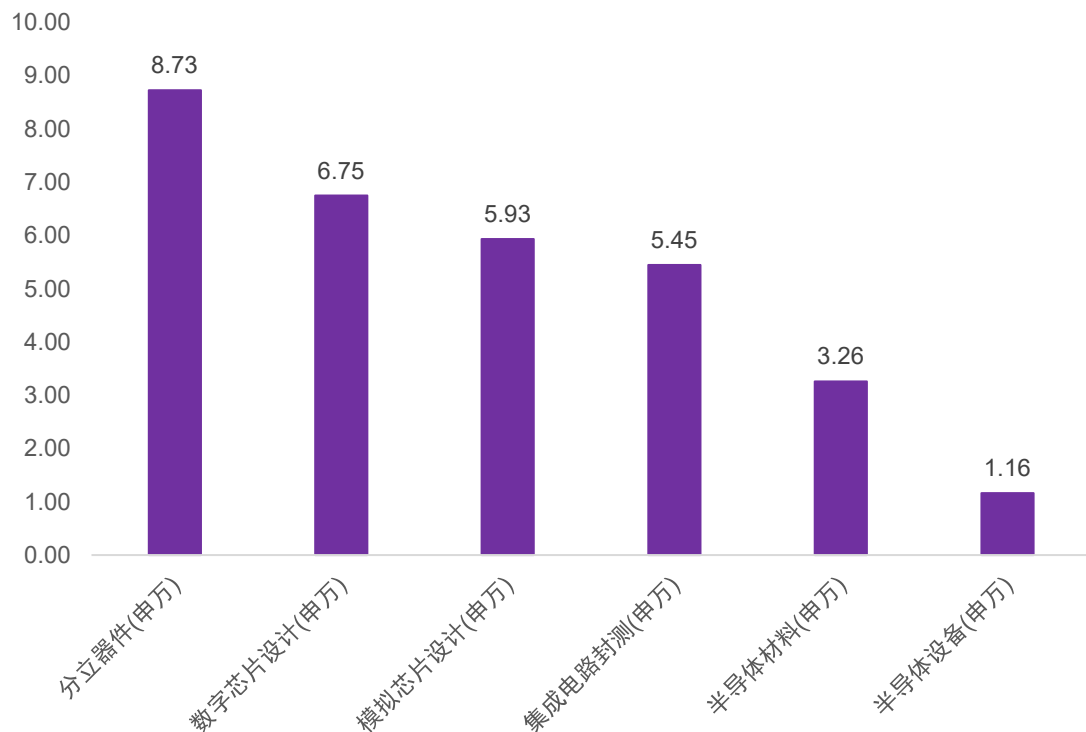


资料来源：wind，华鑫证券研究 注：按申万行业二级分类

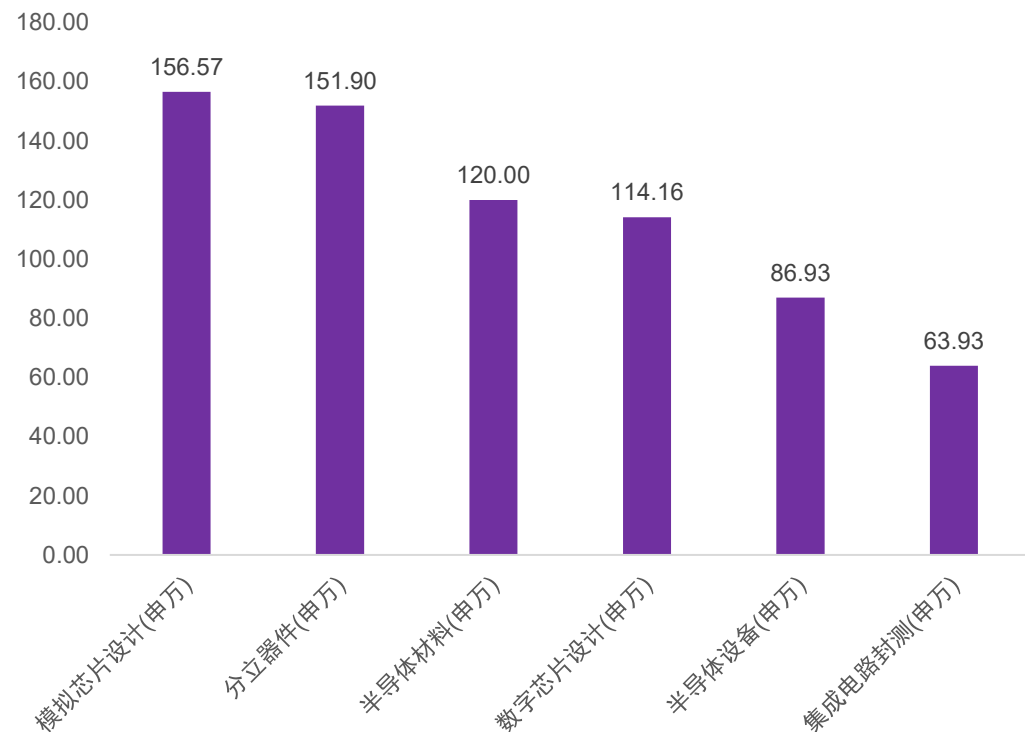
1.3、半导体细分板块周度行情梳理

半导体细分板块比较，4月13日-4月17日当周，半导体细分板块呈上涨态势。其中，分立器件板块涨幅最大，达到8.73%； 半导体设备板块涨幅最小，达到1.16%。估值方面，模拟芯片设计，分立器件，半导体材料板块估值水平位列前三。

图表4：4月13日-4月17日半导体主要指数周涨跌幅比较（%）



图表5：4月17日半导体主要指数市盈率（TTM）比较



资料来源：wind，华鑫证券研究

1.4、申万二级行业板块资金流向

上周申万行业资金流向情况：

电子化学品 II 板块主力净流入0.33亿元，主力净流入率为0.33%，在9个二级子行业中排第1名；计算机设备板块主力净流出31.03亿元，主力净流入率为-1.89%，在9个子行业中排第9名。

图表6：3月2日-3月6日申万行业资金流向情况

行业	主力流入额(万元)	主力流出额(万元)	主力净流入额(万元)	主力净流入率(%)	连续流入天数
SW电子化学品 II	3,871,063.35	3,835,053.62	36,009.72	0.33	2
SW半导体	45,317,374.97	45,463,522.78	-146,147.82	-0.14	-1
SW航天装备 II	1,739,343.83	1,761,555.16	-22,211.33	-0.36	-2
SW消费电子	16,687,752.95	16,980,385.59	-292,632.64	-0.72	-1
SW其他电源设备 II	4,545,847.77	4,633,818.85	-87,971.09	-0.74	-1
SW通信设备	41,859,755.67	42,893,311.69	-1,033,556.03	-1.19	2
SW军工电子 II	6,183,881.33	6,429,542.25	-245,660.93	-1.37	-3
SW其他电子 II	4,087,020.18	4,291,408.21	-204,388.03	-1.84	1
SW计算机设备	5,564,369.58	5,874,661.39	-310,291.82	-1.89	-2

资料来源：wind，华鑫证券研究

1.5、半导体板块公司周涨幅前十股票

4月13日-4月17日当周，半导体板块公司周涨幅前十个股：长光华芯，利扬芯片，锆威特，凯德石英，源杰科技，恒烁股份，臻镭科技，德明利，金海通，翱捷科技-U，周涨幅分别为：37.02%，25.73%，25.58%，20.44%，17.96%，17.15%，17.13%，14.86%，14.77%，13.71%。

图表7：半导体板块公司周涨幅前十股票

证券代码	证券简称	市值(亿元)	EPS			PE			PB	周涨跌幅(%)
			2024	2025E	2026E	2024	2025E	2026E		
688048.SH	长光华芯	578.22	-0.57	-	0.44	-588.67	-	745.54	19.24	37.02
688135.SH	利扬芯片	87.02	-0.31	-	0.09	-147.76	-	-	5.54	25.73
688693.SH	锆威特	75.05	-1.32	-	-	-77.20	-	-	9.44	25.58
920179.BJ	凯德石英	40.63	0.44	-	0.64	100.76	-	84.65	5.41	20.44
688498.SH	源杰科技	1241.94	-0.07	1.34	2.02	-20247.31	1079.95	713.76	53.25	17.96
688416.SH	恒烁股份	74.78	-1.95	-	-	-46.45	-	-	5.89	17.15
688270.SH	臻镭科技	374.93	0.09	-	1.13	1919.29	-	155.06	16.63	17.13
001309.SZ	德明利	1165.28	2.36	3.15	4.57	332.26	228.49	157.68	36.66	14.86
603061.SH	金海通	212.19	1.31	3.02	3.42	270.37	117.23	103.51	12.59	14.77
688220.SH	翱捷科技-U	346.35	-1.66	-0.65	0.41	-49.98	-127.34	203.74	6.35	13.71

资料来源：wind，华鑫证券研究

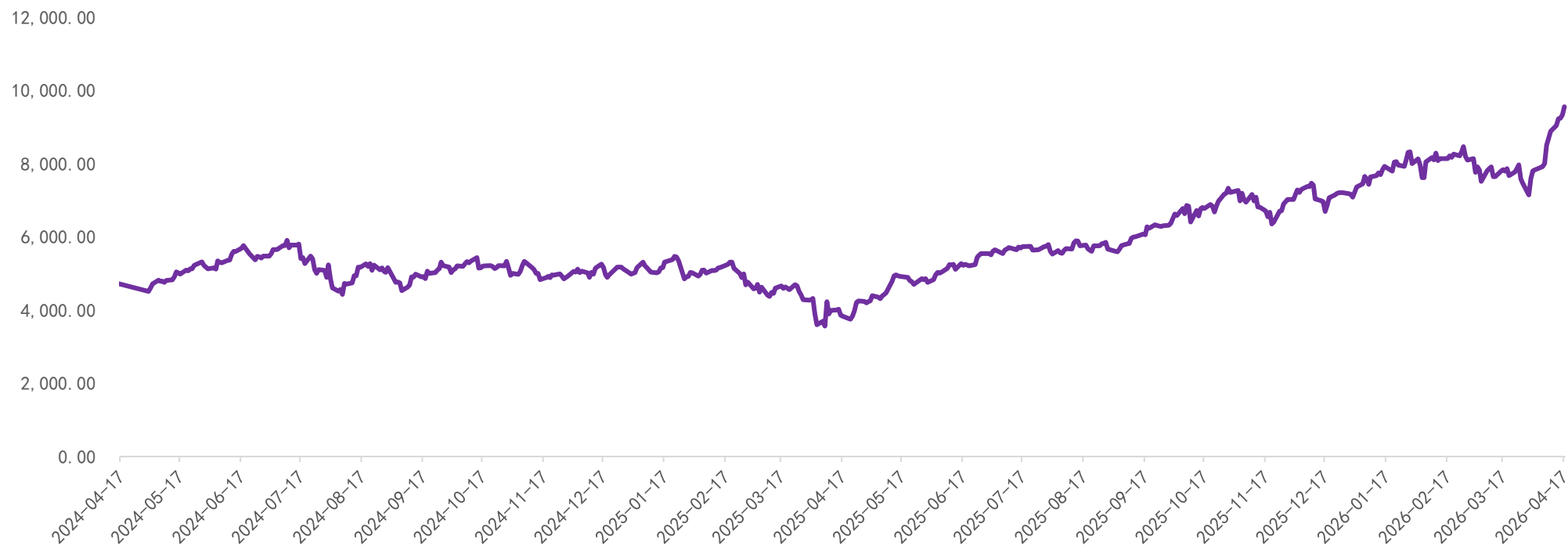
02 行业高频数据

研究创造价值

2.1、半导体：费城半导体指数

海外方面，4月13日-4月17日当周，费城半导体指数总体呈现上涨的态势。更长时间维度上来看，2024年上半年整体处于上升态势，7月出现大幅回调，8月处于震荡下行行情，9月出现探底回升，四季度总体处于震荡的态势。2025年一季度呈现先涨后跌的走势，4月后逐渐回升，之后呈现震荡上行的态势。2026年一季度指数呈现震荡态势。

图表8：费城半导体指数近两年走势

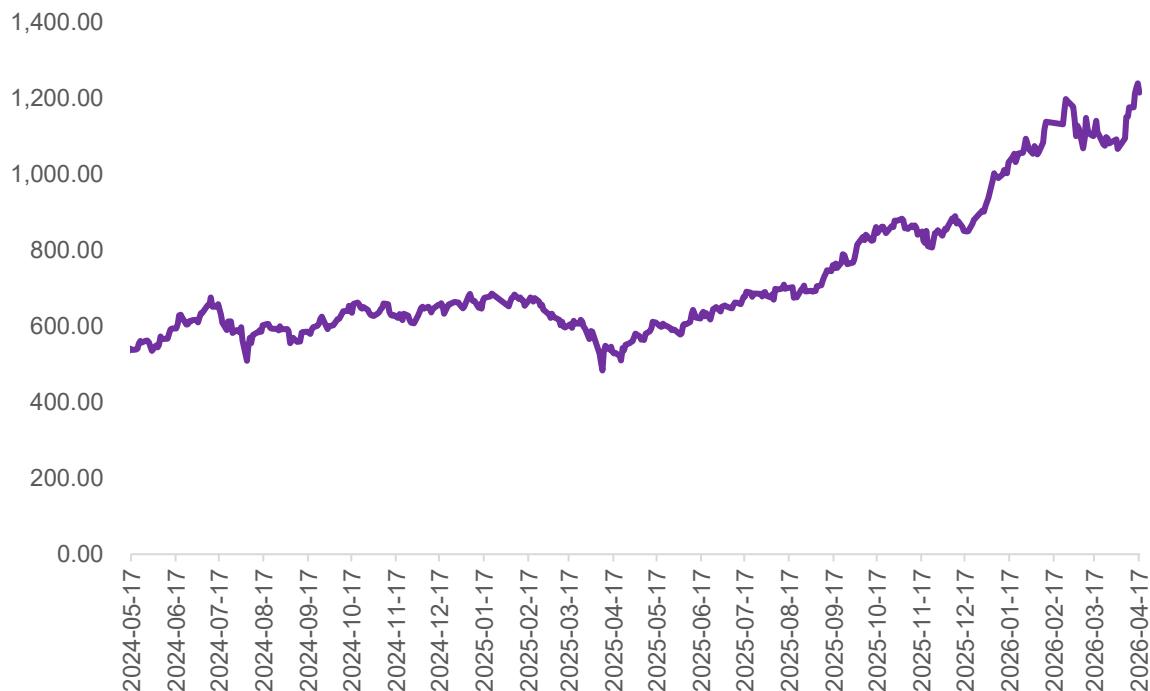


资料来源：wind，华鑫证券研究

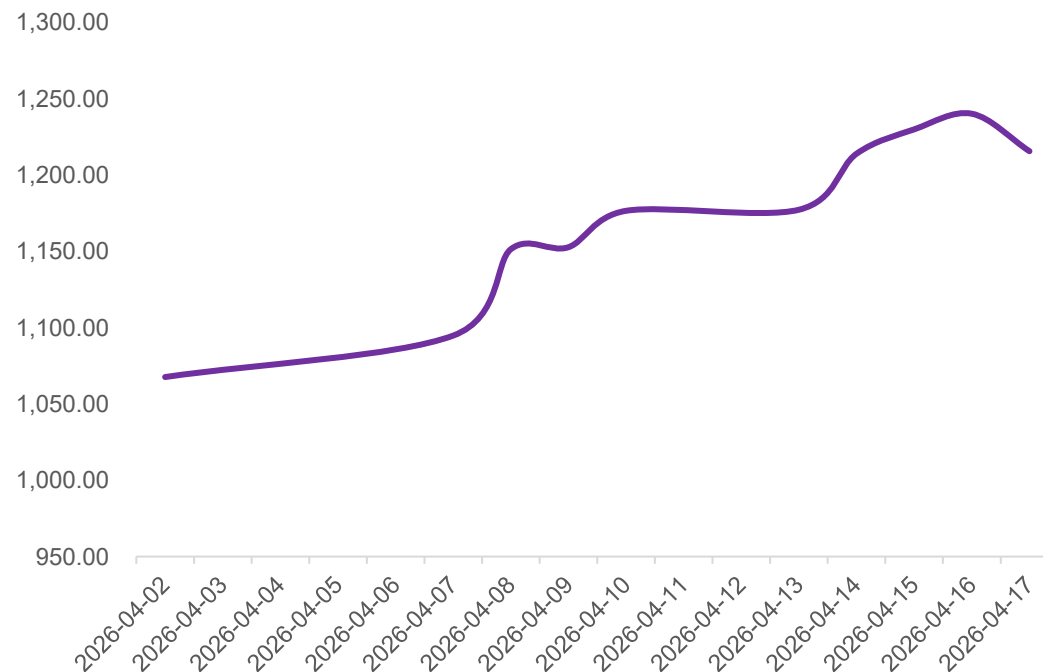
2.2、半导体：台湾半导体行业

此外，我们选取台湾半导体行业指数来观察行业整体景气。近两周来看，4月6日-4月17日两周，台湾半导体行业指数呈现整体上升的态势，随后进入下跌的行情。近两年来看，2024年二季度台湾半导体指数呈现上涨的态势，随后进入震荡行情。2025年一季度台湾半导体指数进入下跌的行情，随后进入上行的趋势。2026年一季度台湾半导体指数呈现震荡态势。

图表9：台湾半导体行业指数近两年走势



图表10：台湾半导体行业指数近两周走势



资料来源：wind，华鑫证券研究

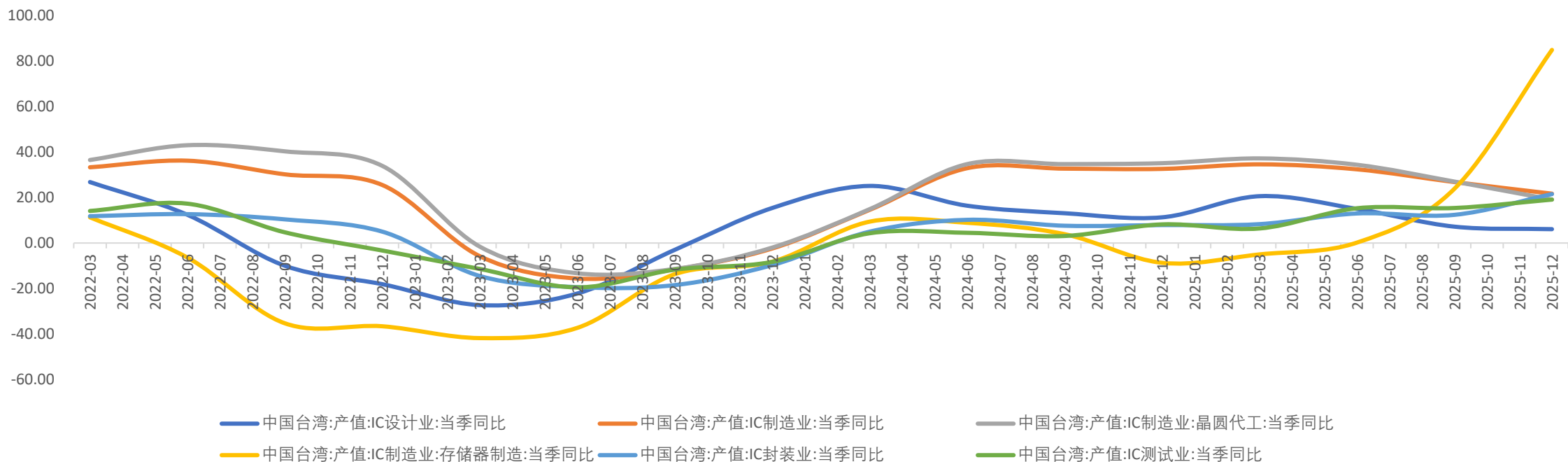
2.3、半导体：中国台湾IC产值同比增速

我们可以通过中国台湾IC产值同比增速，将电子各板块合在一起观察：

中国台湾IC各板块产值同比增速自2021年以来持续下降，从2023年Q2开始陆续有所反弹，各板块产值降幅均有所收窄。IC板块整体表现不佳，主要因为消费电子需求差，导致设计下滑，加之2021年缺货、涨价导致的2022年库存水位上升。但随着AI、5G、汽车智能化等应用领域的推动，2024年需求开始逐步回升。

2025年，中国台湾IC设计、IC制造以及晶圆代工产值同比增速小幅下滑；中国台湾IC封装、测试业产值同比增速为维持平稳的增速；中国台湾存储器制造业进入下半年来，产值同比大幅提升。

图表11：中国台湾IC各板块产值当季同比变化（%）

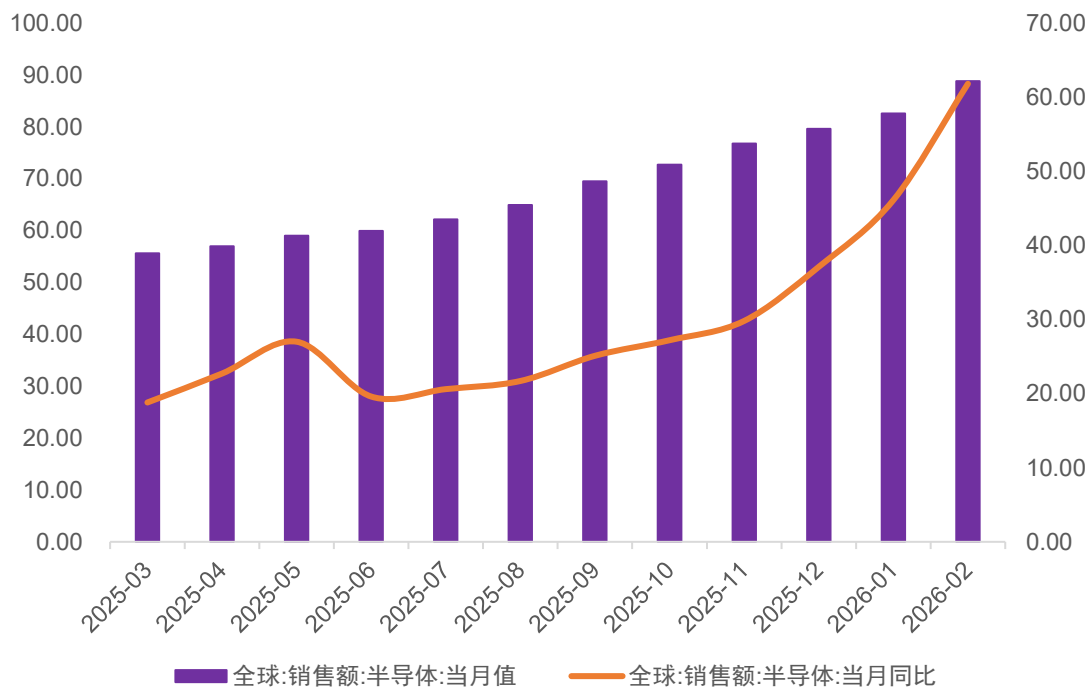


资料来源：wind，华鑫证券研究

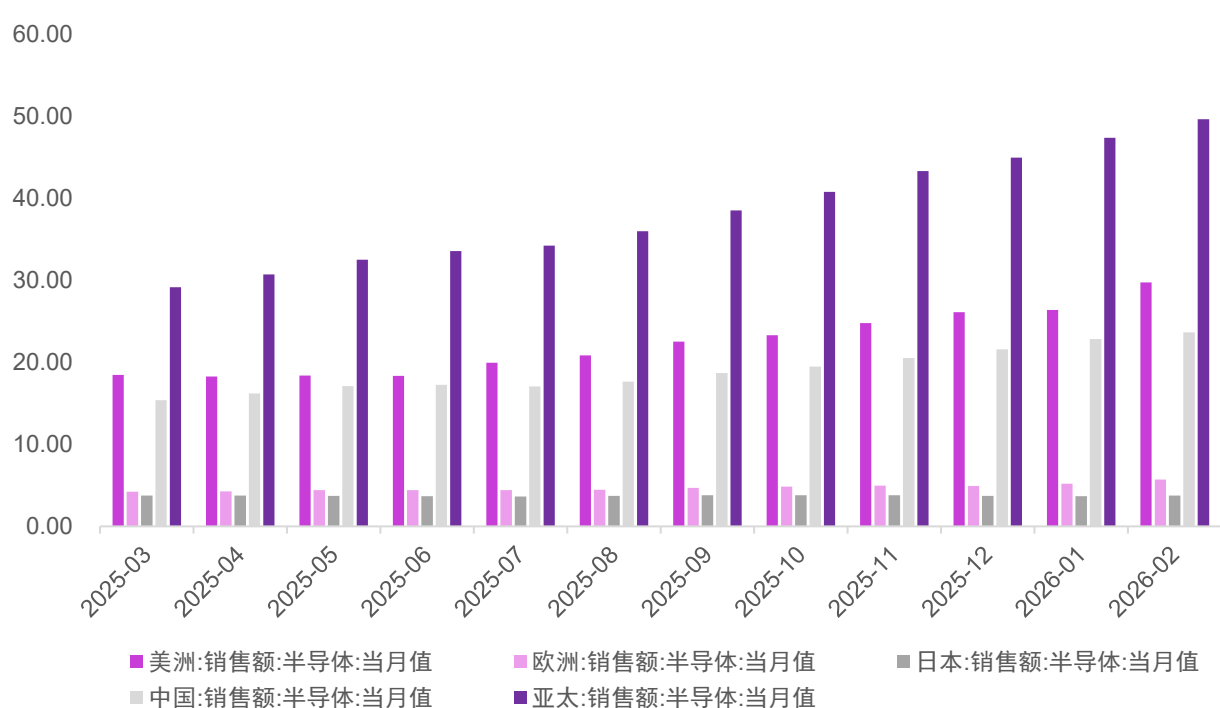
2.4、半导体：全球半导体销售额

全球半导体销售额自2024年年底出现小幅下降。2025年4月以来，全球半导体销售额呈现逐月攀升的态势，半导体行业景气度提升显著，2025年6月增速开始放缓，7-10月增速开始回升。2026年2月，全球半导体当月销售额为887.8亿美元，同比增长61.8%。其中，中国销售额为236.3亿美元，环比增长3.55%，占比达26.62%。

图表12：全球半导体销售额（单位：十亿美元）



图表13：全球半导体销售额按地区划分（单位：十亿美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.6、半导体：中国进口半导体设备数量

从中国进口半导体设备数量的维度来看，2023年以来，中国的半导体设备进口数量整体呈现平稳的态势。结合上文中国大陆半导体设备销售额攀升的趋势，我们认为国产设备正在逐步提升市场份额。

图表15：中国半导体设备及制造半导体器件或集成电路用装置进口数量（台）

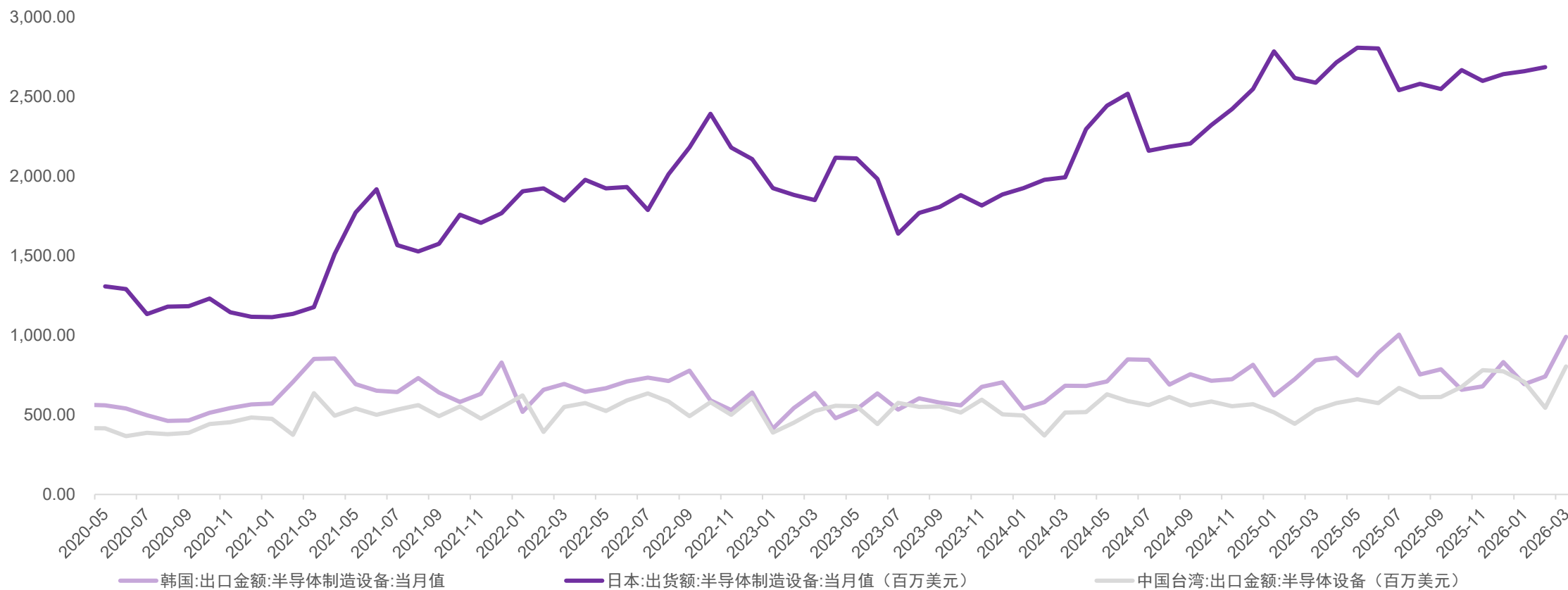


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.7、半导体：海外市场半导体设备出口额

从海外市场半导体设备出口额的维度来看，2019年以来，韩国和中国台湾的半导体设备出口金额整体维持平稳的态势，日本半导体设备出口额整体呈现上升趋势。

图表16：海外市场半导体设备出口金额（百万美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

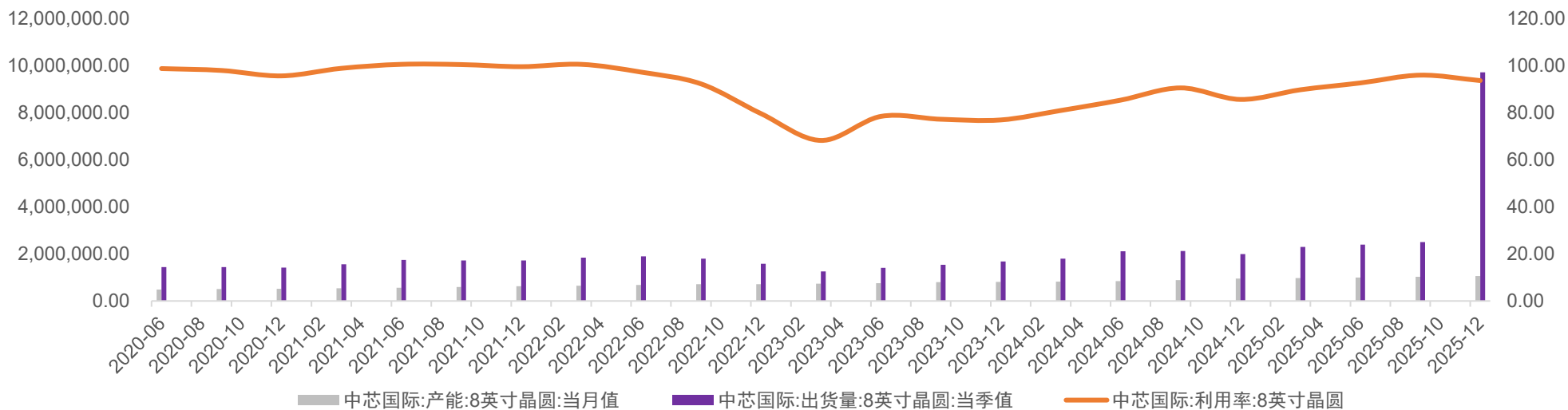
2.8、半导体：晶圆制造

晶圆制造方面，2018年至2025年9月，国产晶圆代工厂商中芯国际8英寸晶圆月产能从约45万片稳步提升至约102.3万片，实现翻倍以上增长，并历经稳步爬升、加速扩张及快速扩产三个阶段，尤其在行业调整期间中芯仍坚持逆周期布局，为后续复苏储备了充足产能。

产能利用率清晰地映射行业周期，从2020-2022年高景气期多次超过100%，到2023年下行期下滑至83.5%，随后自2023年第三季度起强劲反弹，至2025年第四季度已恢复至93.5%的高位，接近满产状态。在产能大幅扩张与利用率快速回升的共同推动下，季度出货量规模显著跃升，2025年第四季度达到近970万片，创历史新高，即便利用率未及上轮峰值，实际产出总量已远超以往。

整体来看，国产晶圆代工厂通过逆周期扩产把握了复苏机遇，出货规模的突破体现规模效应增强，也印证了汽车电子、工业控制、物联网等领域对成熟制程芯片需求的持续性与增长潜力。

图表17：国产晶圆代工厂产能、出货量、产能利用率数据（单位：片）

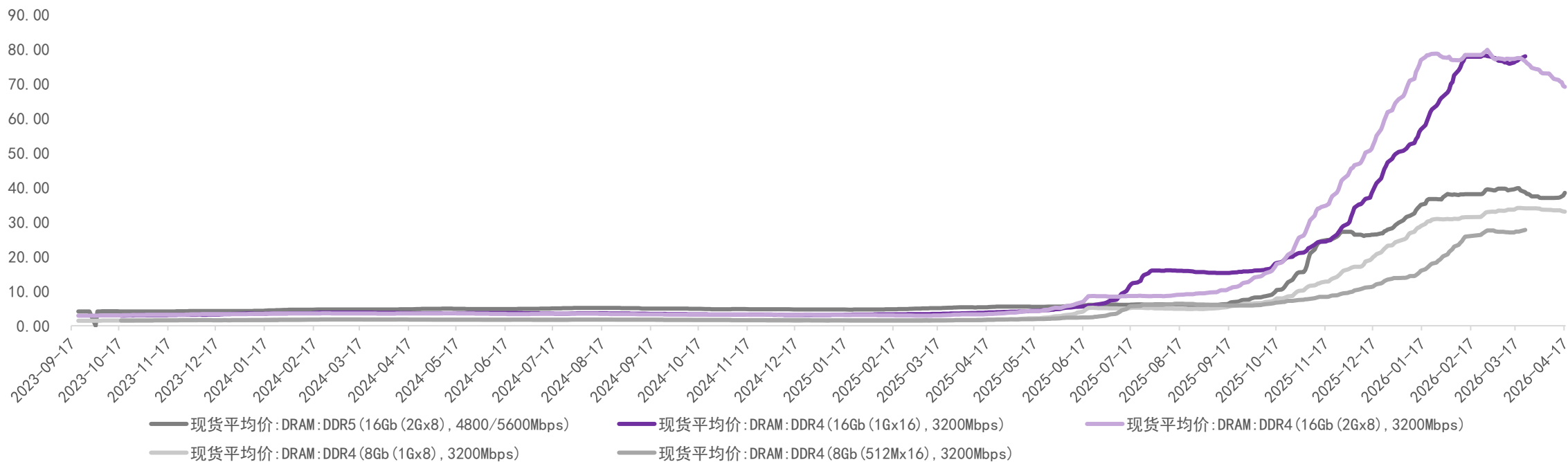


资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

存储芯片方面，由于AI存力需求提升以及海外大厂产能切换HBM等缘故，导致传统DRAM以及NAND类存储芯片价格大幅攀升。NAND方面：Wafer:512GbTLC现货均价从2024年3月底进入小幅回升，10月出现小幅下跌后变化趋于平缓，2025年4月以来趋于平稳，7月后价格进入加速上涨阶段。2026年4月6日价格为21.68美元。DRAM方面：DRAM:DDR5(16Gb(8Gx2),4800Mbps)现货均价从2024年3月以来价格小幅上涨，9月之后又重回下跌态势，2025年1月以来呈现大幅上涨的态势，12月初出现小幅下跌，之后开始进入加速上涨阶段。2026年4月17日价格为38.50美元。

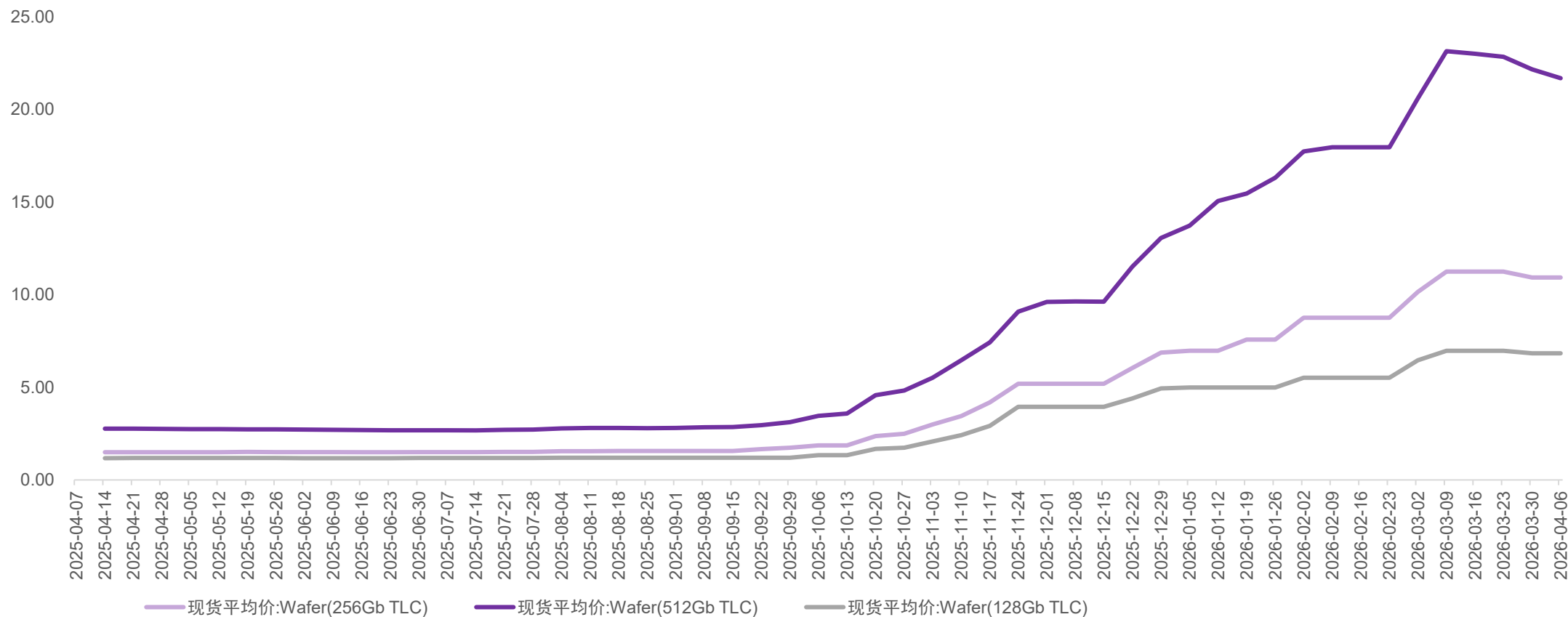
图表18：DRAM价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

2.9、半导体：存储芯片

图表19：NAND价格（单位：美元）



资料来源：wind，华鑫证券研究

03 行业动态

研究创造价值

■ 连续六年，英飞凌蝉联全球车用半导体市场份额第一

根据 TechInsights 发布的 2025 年最新市场分析，英飞凌连续六年蝉联全球车用半导体市场份额第一，并进一步扩大了对主要竞争对手的领先优势。这再次证明了英飞凌在快速发展的汽车行业中作为首选合作伙伴的地位。英飞凌科技执行副总裁兼英飞凌汽车业务首席营销官 Peter Schaefer 表示：“英飞凌持续领跑车用半导体市场，彰显了我们为客户的坚定承诺，以及在应对软件定义汽车和传动系统电气化等核心趋势方面的卓越能力。尤其在微控制器等关键领域，我们的领导地位得到进一步巩固，这凸显了我们的创新实力。同时，我们在全球在所有关键市场的份额均位列第一或第二，充分体现了全球合作伙伴对我们的深厚信任。”

根据 TechInsights 的数据，2025 年全球车用半导体市场规模增长至 744 亿美元。英飞凌自 2020 年首次登顶市场榜首以来，今年再次蝉联冠军，市场份额达到 12.8%，并进一步扩大了与市场第二名的差距。这一成就得益于英飞凌在全球所有重要汽车区域的强劲布局：在中国（全球最大的车用半导体市场）以及欧洲和韩国，英飞凌均巩固了其区域市场领导者地位，并在中国和欧洲两地持续拉大对第二名的领先优势。在北美和日本市场，英飞凌位列第二，并显著缩小了与当地市场领导者的差距。

在至关重要的汽车微控制器（MCU）领域，英飞凌再次显著扩大了其领先优势。2025 年，英飞凌在该领域的市场份额上升至 36.0%，同比增长 3.9 个百分点，进一步拉开了与竞争对手的差距。微控制器在汽车领域的关键创新中发挥着决定性作用。它们不仅能确保电力传动系统精确高效地运行，实现高级驾驶辅助系统和自动驾驶中安全可靠的实时决策，更是支撑在软件定义汽车中实现软件及功能更新的电子电气架构的基石。自 2020 年以来，凭借对系统创新的专注以及满足全球车企和一级供应商（Tier 1）需求的能力，英飞凌始终稳居全球车用半导体领域的领导地位。最新的 TechInsights 数据证实了英飞凌在技术变革浪潮中的强劲表现和持续的市场领导力。

营收增长毛利率下滑，国产设备商的“内卷”加速

4月17日消息,《掘经亚洲》报道,2025年中国本土半导体设备厂商北方华创(Naura)、中微公司(AMEC)、盛美(ACM Research)和拓荆科技(Piotech)等大都实现了创纪录的收入。同时,中国晶圆厂通过新加坡和马来西亚进口美系设备的数量创纪录,大幅减少了美国的直接进口。北方华创是四家公司中产品线最广泛的,仅2025年前三个季度营收就达到273.01亿元人民币,而其2020年全年营收仅为60.56亿元人民币,增长了约3.5倍。中微公司2025年营收90.65亿元,相比2020年的22.73亿元增长了3倍。盛美上海2025年营收67.86亿元,相比2020年的10亿元营收增长了5.79倍;拓荆科技2025年营收达41.03亿元,相比2020年的4.36亿元增长了8.4倍。

芯智讯查询财报数据显示,北方华创毛利率于2022年达到43.83%的近年高点,到2025年前三季度已降至41.41%;中微公司的毛利率于2023年达到45.83%的高点,2025年则降至了39.17%;盛美上海毛利率于2023年达到51.99%的高点,2025年的毛利率已经降至48.32%;拓荆科技2022年毛利率49.27%为近年高点,2025年前三季度毛利率已降至33.28%。

在毛利率下滑的同时,各家国产设备商为提升营收,都开始了业务扩张,将产品线延伸到了其他领域,与更多的友商形成了更多层面的竞争,内卷全面加速。一些设备商为了将设备导入晶圆厂,不惜打折,甚至直接免费送,竞争变得更加的残酷。在国产半导体设备市场加速内卷的同时,国内对于海外设备的进口保持高位。虽然由于美国的出口管制,直接从美国进口的设备额在降低,但是从新加坡、马来西亚等东南亚地区的进口额却在增加。

另据《日经亚洲》报道,中国海关记录显示,中国2025年直接从美国进口半导体设备仅有20亿美元,同比下降超过34%,为2017年以来最低的年度数字。从新加坡进口半导体设备总额为57亿美元,同比增长超过17%,而进口自马来西亚的半导体设备则翻倍至34亿美元。

三星宣布LPDDR4/4X年底停产

据韩国媒体The Elec报道，其于4月17日确认，三星电子已正式停止接收LPDDR4和LPDDR4X的新增订单，标志着这两款量产逾十年的主流内存产品正式进入EOL（生命周期终结）阶段。

业界普遍认为，此次订单窗口的持续时间已高于预期，根本原因在于客户端需求持续旺盛一局面虽帮助客户充分锁定了部分LPDDR4系列内存供应，但也相应推迟了三星产线转换的节奏。

三星此次计划停产LPDDR4系列，最核心的原因在于HBM（高带宽内存）和先进DDR5产品的利润率更高。叠加 AI 浪潮下先进内存供不应求，三星希望将有限晶圆、产能资源全部倾斜到利润率更高的产品线上，不再维持低利润旧代产品产能。预计此举将直接影响三星自身移动业务部门及众多的外部客户。

三星部分客户已在加快推进下一代芯片开发，以配合LPDDR4/4X的库存消耗进程。一位业内人士表示：“今年所需的LPDDR DRAM我们已经备足，但下一代芯片将针对升级后的内存规格进行设计。”值得注意的是，车载芯片厂商Telechips已在今年响应客户需求，将芯片设计从LPDDR4/4X切换至LPDDR5/LPDDR5X。该公司专注于ADAS（高级驾驶辅助系统）及车载信息娱乐系统领域的汽车半导体研发。

数据显示，这一“产能转移”已经引发价格的剧烈波动。三星LPDDR4X内存报价从2025年3月的6美元/颗飙升至2026年1月的28.5美元/颗，不到一年涨幅接近4倍。三星的产线转换计划不止于LPDDR4。

据报道，三星正在推进多条产线的设备转换，其中华城工厂的12号线计划停止2D NAND闪存生产，将其改造为1c DRAM专用的“End Fab”设施，用于处理金属互联等后端工艺。1c DRAM节点目前是三星最大的产能瓶颈。而对于国产存储芯片厂商（如长鑫存储）来说：如果能够填补三星退出后留下的中低端内存市场空白，将有望在2026年下半年迎来一波订单红利。

3.4、行业动态整理

微软Surface全面涨价，最高涨幅30%

4月14日，微软宣布大幅调涨Surface品牌系列笔记本电脑价格，涨幅超30%，成为了又一家因为内存芯片及CPU等关键器件等成本上涨而被迫涨价的PC厂商。具体来说，微软去年上市的12英寸Surface Pro当时的起售价为800美元，如今售价已涨至1,050美元起，涨幅超过30%。老款的13英寸Surface Pro第11代目前价格1,500美元，比2024年上市时的1,000美元，贵了数百美元。最新一代的13.8英寸Surface Laptop价格则大涨了500美元。随新价格生效，微软已不再提供任何低于1,000美元的Surface PC。

微软表示，由于近期内存和零件成本上涨，Surface开始更新Microsoft.com网站上现有硬件系列产品的售价。微软强调，虽然目标是维持价格稳定，但仍会根据“市场状况和营运成本”等多重因素，定期检视并评估Surface产品定价。调整后的价格可视为微软下批Surface硬件成本的新基准，该公司预计在未来几周内发表新款Surface系列装置。

微软Surface系列的市场定位偏向中高端，相对于其他Windows PC，微软产品虽在设计上有独到之处，但同样的硬件配置前提下，价格却普遍偏高，加上微软经营重心偏重软件及云端服务，这也造成Surface硬件多年来无法有效放量。

微软从未公布Surface系列出货量，业界普遍预估其年出货量顶多几百万台规模，在整体PC市占率不到5%，微软Surface系列产品由和硕及广达代工制造。

和硕联席CEO邓国彦先前指出，第二季预期笔记本电脑与PC产品出货将回升；全年来看，笔记本电脑由于有新客户及新项目加入，将呈现逐季成长，但仍受到地缘政治、内存供货影响。

广达今年一季度笔记本电脑出货1,000万台，环比下滑8.3%，同比下滑7.4%，优于公司预期。值得一提的是，苹果近期推出的平价笔记本电脑MacBook Neo主要由广达代工交货，成功推升广达首季笔记本电脑出货表现，若后续美系客户追加订单，广达有机会持续受惠，并成为今年笔电业务主要动能之一。

长光华芯2025年营收增75.09%，利润分配预案待股东会审议

2026年4月18日，长光华芯发布2025年年度报告摘要。公司已建成IDM全流程工艺平台和2吋、3吋、6吋量产线，业务覆盖半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器等。产品包括高功率单管、巴条、VCSEL及光通信芯片系列等，应用于光纤激光器、激光雷达、光通信等领域。

经营模式上，盈利靠销售半导体激光芯片等产品；国内直销、海外代理销售；采购有供应商管理制度；研发分6个阶段；生产采用“订单式”为主、“库存式”为辅模式。

行业方面，半导体激光行业应用广泛，技术门槛高。公司是国内高功率半导体激光芯片领军企业，2025年巩固龙头地位，迈向“多元化平台型”公司。

财务数据显示，2025年总资产336021.45万元，较上期增加1.76%；净资产300893.32万元，较上期增加0.77%；营业收入47737.76万元，同比上升75.09%；利润总额1347.97万元；净利润2176.41万元；扣非净利润 - 3293.57万元。

股东方面，截至报告期末普通股股东总数28373户。前十大股东中，苏州华丰投资中心（有限合伙）持股18.38%，苏州英镭创业投资合伙企业（有限合伙）持股13.34%等。

2025年利润分配预案为不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，该方案已通过公司第二届董事会第二十次会议审议，尚需公司2025年年度股东会审议通过。

04 公 司 公 告

研究创造价值

慧智微:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

一、公告概况

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，无需提交股东大会审议。本事项的保荐人为华泰联合证券有限责任公司，已出具无异议的核查意见。公告发布于2026年4月18日。

二、投资主要内容

公司拟使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环使用。投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款及协定存款。

投资目的是在确保募投项目资金安全和正常投入的前提下，提高资金使用效率，增加资金收益。

三、募集资金情况

慧智微于2023年首次公开发行股票，共募集资金总额113,596.65万元，扣除发行费用后净额为102,832.89万元，并已于2023年5月10日全部到账。募集资金主要用于总部及广州研发中心建设项目、上海研发中心建设项目及补充流动资金。截至2025年6月30日，三个项目的累计投入进度分别为87.44%、91.87%和77.19%。

四、过去12个月资金管理回顾（2025年4月18日至2026年4月17日）

公司此前已两次批准使用暂时闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别为3.5亿元（2024年4月）和2亿元（2025年4月）。最近一年，公司投入资金约1.1亿元用于普通大额存单和1亿元用于结构性存款，共实现收益约159.78万元，当前尚有约9,000万元本金未收回。

五、风险与控制措施

虽然投资产品以安全性和流动性为主，但仍存在宏观经济波动带来的收益不确定性风险。

公司建立了决策、执行、监督分离的内部机制，严格按照规定审批投资事项。主要选择信誉良好、规模较大、资金安全有保障的金融机构产品。公司审计委员会将定期监督使用情况，并在必要时聘请外部专业机构审计。

欧莱新材:2025年年度报告摘要

一、重要提示

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，同时结合行业发展情况、公司发展阶段、公司2026年经营计划和资金需求等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。公司2025年度利润分配预案已经公司于2026年4月16日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、公司基本情况

1、公司主营业务情况：报告期内，公司全面贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，聚焦夯实高性能溅射靶材业务，同时积极向产业链上下游拓宽。

2、公司主要产品情况

(1) 高性能靶材：公司靶材产品涵盖约40种金属、合金及陶瓷化合物靶材，包括铜、铝、钼、ITO、TCOM等，广泛应用于半导体显示、集成电路、太阳能电池、新能源电池等领域。产品在纯度、致密度、晶粒度、焊合率等方面达到行业领先水平，市场认可度高。

(2) 高性能金属：该业务是公司全产业链战略的核心上游环节，与靶材业务协同互补，形成“材料-靶材-应用”一体化优势。主要聚焦高纯无氧铜、稀散金属及铜基新材料，成为集成电路、核医疗、超导等前沿领域的关键材料供应商。

(3) 前沿科技领域关键材料与核心零部件：公司利用高纯铜制备与精密加工优势，布局核医疗、超导、可控核聚变等前沿领域，构建“材料-部件-系统”一体化供应能力。已切入核医疗RFQ加速腔核心部件供应体系，未来将推动由研发突破向规模化交付转变，成为公司新的长期增长引擎。

3.主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式稳定，未发生重大变化。

长光华芯:2025年年度报告摘要

一、重要提示

本报告摘要摘自年度报告全文，投资者应阅读上海证券交易所网站发布的完整报告以了解公司经营、财务及发展规划。公司已在“管理层讨论与分析”部分详细说明可能存在的风险因素。公司董事会及全体高管保证报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。所有董事均出席审议会议，天衡会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告。公司上市时已实现盈利，董事会通过的2025年利润分配预案为：不派发现金红利、不转增股本、不送红股，母公司仍存在未弥补亏损，方案已获董事会通过，待股东大会审议。公司无特殊治理安排事项。

二、公司基本情况

1. 公司简介：公司股票简称为“长光华芯”，股票代码688048，上市于上海证券交易所科创板。公司总部位于苏州高新区漓江路56号，董事会秘书为闵大勇，证券事务代表为孙亮。
2. 报告期主要业务简介：公司专注半导体激光芯片的研发与制造，拥有覆盖芯片设计至封测的完整IDM工艺平台，是国内少数具备高功率芯片量产能力的企业。依托核心技术，公司业务横向拓展至VCSEL及光通信芯片领域，纵向延伸至器件、模块及直接半导体激光器，实现上下游一体化布局。主要产品涵盖高功率单管、巴条、VCSEL及通信芯片，广泛应用于激光加工、光通信、消费电子、激光雷达、医学与科研等领域。报告期内，公司主营业务保持稳定，产品结构与方向未发生重大变化。
3. 主要经营模式：公司通过自主研发、生产并销售半导体激光芯片及下游器件、模块实现盈利。国内市场以直销为主，海外市场以代理经销为主。客户开发方面，公司通过展会、学术会议、客户拜访、行业推广等方式拓展市场；对于新产品，需经历设计、样品测试、客户验证、小批量供货到批量供货的导入过程，逐步形成稳定供货关系。

北方华创:2025年度内部控制评价报告

一、重要声明

公司董事会对内部控制的建立、执行及披露负主体责任，审计委员会负责监督，经理层负责组织实施。内部控制旨在保障经营合规、资产安全、财务报告真实与经营效率提升，但因存在固有限制，仅能提供合理保证。

二、内部控制评价结论

截至2025年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制的重大缺陷，内部控制体系在所有重大方面保持有效。自评价基准日至报告发出日，未发生影响结论的事项。

三、内部控制评价工作情况

（一）评价范围

评价覆盖公司全部事业群及纳入合并报表范围的子公司，资产与收入占比均为100%。内容涵盖组织架构、风险评估、资金、合同、研发、资产、人力资源及信息化等领域，重点关注合同、资金、外包、资产及研发管理等高风险环节。

（二）评价依据与缺陷认定

公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合内部制度和评估手册执行评价。

财务报告和非财务报告缺陷均采用定量与定性标准综合认定：定量方面，以利润总额及资产总额为基准，划分一般、重要、重大缺陷；定性方面，涉及舞弊、控制环境无效、重大错报、制度缺失或违法违规等情形的认定为重大缺陷。

（三）缺陷认定及整改情况

报告期内，公司未发现财务报告或非财务报告重大、重要缺陷，内部控制运行有效。

恒烁股份:2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒烁股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒烁股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是恒烁股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对恒烁股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的恒烁股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了恒烁股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

长光华芯:关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

一、适用对象

董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案具体内容

1、公司董事薪酬方案

公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年9.6万元（税前）；其他董事根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬，不再另行领取津贴。

3、其他规定

- （1）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
- （2）具体薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

四、审议程序

2026年4月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者而需回避表决，故将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

北方华创:关于会计政策变更的公告

一、会计政策变更概述

(一) 会计政策变更原因及适用日期：2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》，规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。根据财政部上述通知要求，公司将对现行会计政策予以相应变更。

(二) 变更日期：财政部于2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》，公司自2026年1月1日起开始执行前述规定。

(三) 变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四) 变更后采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五) 会计政策变更的程序：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议批准。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

05 风 险 提 示

研究创造价值

半导体出口管制及制裁加码风险

晶圆厂扩产进度不及预期风险

核心技术研发进展不及预期风险

地缘政治环境不稳定风险

重点覆盖公司业绩不及预期风险

何鹏程：悉尼大学金融硕士，中南大学软件工程学士，曾任职德邦证券研究所，2023年加入华鑫证券研究所。专注于半导体、PCB行业。

张璐：早稻田大学国际政治经济学学士，香港大学经济学硕士，2023年加入华鑫证券研究所，专注于光通信、存储等领域研究。

石俊烨：香港大学金融硕士，新南威尔士大学精算学与统计学双学位，研究方向为PCB方向。

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。本报告由华鑫证券制作，仅供华鑫证券的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于公开资料，华鑫证券研究部门及相关研究人员力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。我们已力求报告内容客观、公正，但报告中的信息与所表达的观点不构成所述证券买卖的出价或询价的依据，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并同时结合各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就财务、法律、商业、税收等方面咨询专业顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华鑫证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露。

本报告中的资料、意见、预测均只反映报告初次发布时的判断，可能会随时调整。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，华鑫证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华鑫证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告版权仅为华鑫证券所有，未经华鑫证券书面授权，任何机构和个人不得以任何形式刊载、翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若华鑫证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，华鑫证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成华鑫证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。如未经华鑫证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。华鑫证券将保留随时追究其法律责任的权利。请投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的华鑫证券研究报告。

证券投资评级说明

股票投资评级说明：

	投资建议	预测个股相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	买入	>20%
2	增持	10%—20%
3	中性	-10%—10%
4	卖出	<-10%

行业投资评级说明：

	投资建议	行业指数相对同期证券市场代表性指数涨幅
1	推荐	>10%
2	中性	-10%—10%
3	回避	<-10%

以报告日后的12个月内，预测个股或行业指数相对于相关证券市场主要指数的涨跌幅为标准。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以道琼斯指数为基准。



华鑫证券

CHINA FORTUNE SECURITIES

研 究 创 造 价 值